

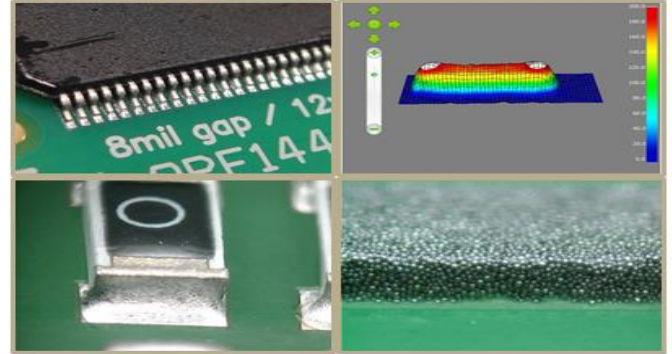
## M8 SOLDADURA EN PASTA NC

### CARACTERÍSTICAS

- Bajo nivel de formación de vacíos (voids): <5% en BGA y <10% en BTC
- Excelentes eficiencias de transferencia de impresión <0.50 AR
- Elimina defectos HiP
- Cumple con REACH y RoHS\* - Libre de halógenos
- Formulada para uso con polvos T4 y más finos
- Potente mojado (wetting) en acabados de superficie sin plomo
- Residuo transparente mínimo. Cumple con requisitos LED
- Pasa prueba Bono y SIR para automotriz

### DESCRIPCIÓN

M8 soldadura en pasta NC lleva el rendimiento al siguiente nivel. Desarrollada en combinación con T4 y polvos finos con y sin plomo, M8 proporciona eficiencias de transferencia estables requeridas para los dispositivos UFP y umBGA de hoy en día, reduciendo DPMO en las aplicaciones más complejas. Los activadores de M8 reducirán los defectos relacionados al mojado (wetting), como HiP (cabeza en almohada), y proporcionarán uniones lustrosas y lisas. M8 ha reducido voiding en BGA y BTC a valores tan bajos como <5% en BGA y <10% en almohadillas de tierra BTC. M8 pasa estrictos requisitos de prueba SIR y electroquímica automotriz y de alta confiabilidad.

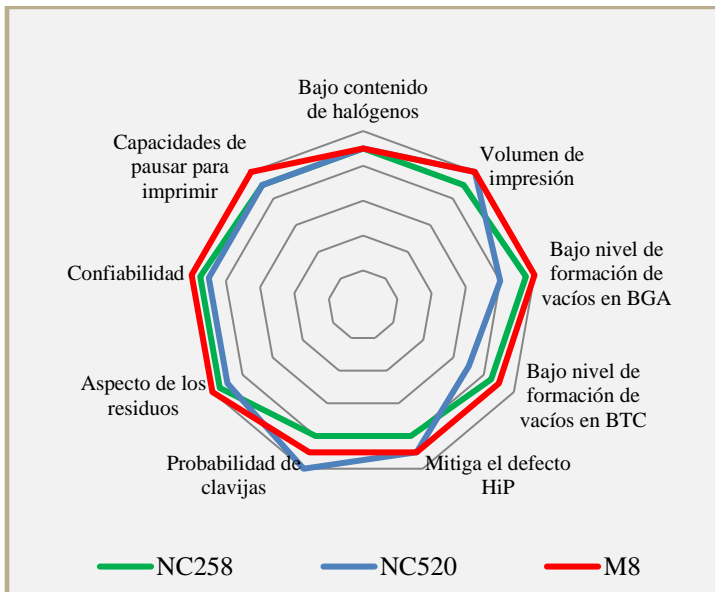


### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Hora	Temperatura
Vida útil de pasta cerrada y refrigerada	1 año	0°C-12°C (32°F-55°F)
Vida útil de pasta cerrada no refrigerada	3 meses	< 25°C (< 77°F)

No agregue pasta usada al contenedor de pasta nueva. La pasta usada deberá ser almacenada por separado y la pasta nueva requiere un sellado hermético, ya sea con tapa interna o tapón. Una vez abierta, la vida útil de la soldadura en pasta dependerá de la aplicación y el entorno. Consulte la guía de manejo de pasta de AIM para más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de M8 para información específica del producto.

### CARACTERÍSTICAS



\*Aleaciones sin plomo

### LIMPIEZA

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la pasta para soldadura M8 de plantillas durante el proceso. Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del equipo de limpieza de las plantillas. DJAW-10 no secará la pasta M8 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte superior de las plantillas. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como enjuague final de las plantillas. Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de M8 pueden permanecer en el conjunto después del reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio limpiar, AIM trabajó estrechamente con socios de la industria para asegurarse de que los residuos de M8 se puedan eliminar con eficacia con agentes removedores de fundente comunes. Comuníquese con AIM para obtener información sobre la compatibilidad de limpieza.





## PERFIL DE REFLUJO

Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

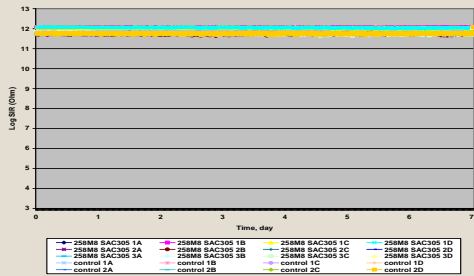
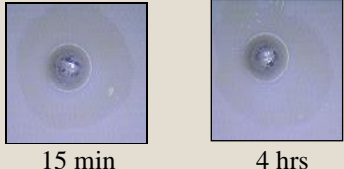
## IMPRESIÓN

Los Ajustes Iniciales Abajo Recomendados Son Dependientes Del Diseño Del PCB Y PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de la Boquilla	0.4 - 0.7kg/25mm
Velocidad de la Boquilla	13 – 152 mm/second
Distancia de Desprendimiento	On Contact 0.00 mm
Distancia de Separación del PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Separación del PCB	3 - 20 mm/second

## DATOS DE PRUEBAS

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC	J-STD-004	ROLO	
Clasificación IPC	J-STD-004B 3.3.1	ROL1	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Densidad de masa*		4.2 gr/cm <sup>3</sup> (SAC305)	
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>
Haluros cuantitativos	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	Br: 0.24% Cl: 0.0% Típico	
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	No fluoride	

\*Densidad de la masa solo aplica para SAC305. Para todas las demás aleaciones, por favor contacte el equipo de AIM.

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	Todas las mediciones en los patrones de prueba exceden 100 MΩ	
Prueba Bono		PASA Fc<8.0 Tipico	
Bomba de Oxígeno Pruebas de halógenos	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Br <50.1 mg/Kg Cl <125 mg/Kg	
Migración electroquímica	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Sólidos del fundente, determinación de no volátiles	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	94.8% Tipico	
Valor Ácido Determination	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	136 mgKOH/g flux Tipico	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	400-1000 Kcps	
Viscosidad (Pa.S)	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	120 Tipico	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	PASA	
Depresión	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Fuerza de Adhesion	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	36.1 gf Time 0 Tipico	